光ファイバの

超低損失接続用ジェル

Best Match Gel®

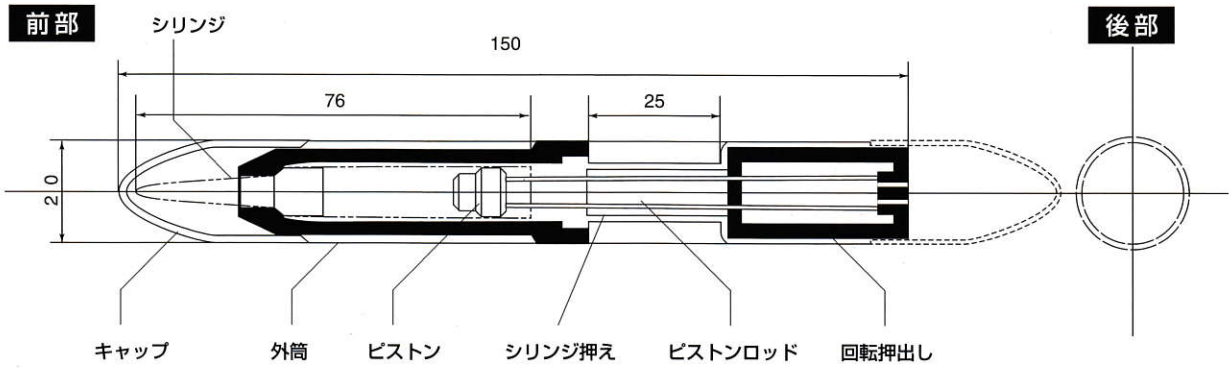
Best match for a fiber optic system

ベストマッチジェル BMG04

主な用途

●光コネクタ中継接続　●光ファイバの心線突き合わせ接続　●光導波路型光多分岐器実装用

原寸大



ディスペンサー構造図

使用方法

1. ディスペンサー後部を1ノッチ右回転させ、異物混入防止のため最初の吐出ジェルをワイパーにて除去します。
2. ディスペンサー後部を再度1ノッチ右回転させると、定量（球状5mg）のジェルが吐出します。
3. 接続をしようとする光ファイバ心線又は光コネクタ（フェルール）の片側端面のみ、中央部分にジェルを塗布します。
4. 塗布が完了したならば

光コネクタ中継接続	→	中継アダプタに挿入固定し作業終了
光ファイバ心線突き合せ接続	→	V溝に固定し作業終了
光導波路型光多分岐器実装用	→	導波形状の溝に固定し作業終了

SM、MM、POFなどのあらゆる光ファイバに適用。

仕　　様

接続損失	**0.01～0.02dB以下** ファイバ表面の傷による光の拡散、屈折率の差による光の反射などを減少させ、オフセット時の損失も低減させます。
動作温度	**−40℃～120℃** ヒートサイクルに極めて強く、凍結から煮沸までの劣悪環境でも使用が可能です。
耐水効果	**強力な撥水性** ファイバ接続部への浸水や結露によって光の透過を阻害されることは全く無く、水中で使用しても接続損失は変わりません。
保証期間	**20年** 光学特性は、動作範囲内の温度、湿度等に影響されません。
形状	**ディスペンサー型** ペン型のため、持ち運びに便利で狭い場所での塗布作業も簡単にできます。ディスペンサー内に粉塵が混入する恐れもありません。
内容量	**2000mg**
塗布量	**5mg（定量吐出）** 1ノッチ5mg（接続の為の最低必要量）の定量吐出で無駄がありません。1本で150～200回の使用が可能です。
粘度	**100,000～150,000cP（ゼリー状）** 高粘度のため、塗布時の作業性が高く、使用環境や経時変化による流出や気化による光学特性の変化がありません。
研磨	**ダイヤモンド紙（緑色30μm）で3～5回の粗研磨仕上げ** 非常に軽便な研磨作業で超低損失接続が可能です。
作業時間	**約30～60秒** 作業時間を短縮でき、コストを大幅に削減できます。

物　　性

組成	シリコン混合物
外観	無色透明な凝結体
比重	0.97
光屈折率	1.465（一般的な光ファイバの屈折率に対応）
引火点	320℃（クリーブランド開放式）
発火点	引火点以上
自己反応性	自然発火、粉塵爆発なし
分解・溶融	水・アルコールに不溶
耐酸性	酸化しない
粉塵	表面に付着するが、組織体への浸透は認められない
耐圧・耐震性	加圧により変形し、加圧体に密着する
耐薬品性	殆どの薬品に対し安定している
安全性	亜鉛、鉛、カドミウム、セレン、総クロム、銅、ヒ素(As_2O_3)、PCB、ホルムアルデヒド、総水銀は検出しない

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記まで

WIRED SEATTLE TOKYO

株式会社 ワイヤードジャパン

〒140-0015　東京都品川区西大井1-8-1
TEL 03-5709-0384　FAX 03-5709-1309

WIRED INC.

720 Olive way, Suite 1025
Seattle, Washington 98101 U.S.A.
TEL 206-623-5714　FAX 206-623-5837